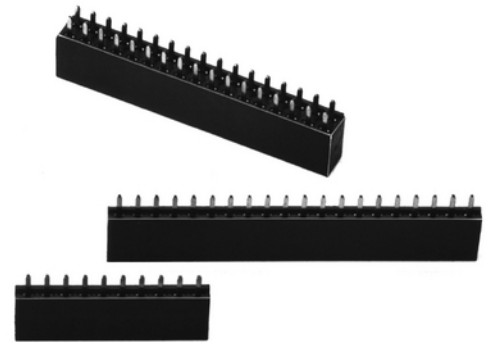


Buchsenleisten - RM 2,54mm - BH 8,4mm - 1-/2-/3-reihig Female Headers - 2,54mm Pitch - 1-/2-/3-Rows - 8,4mm Height

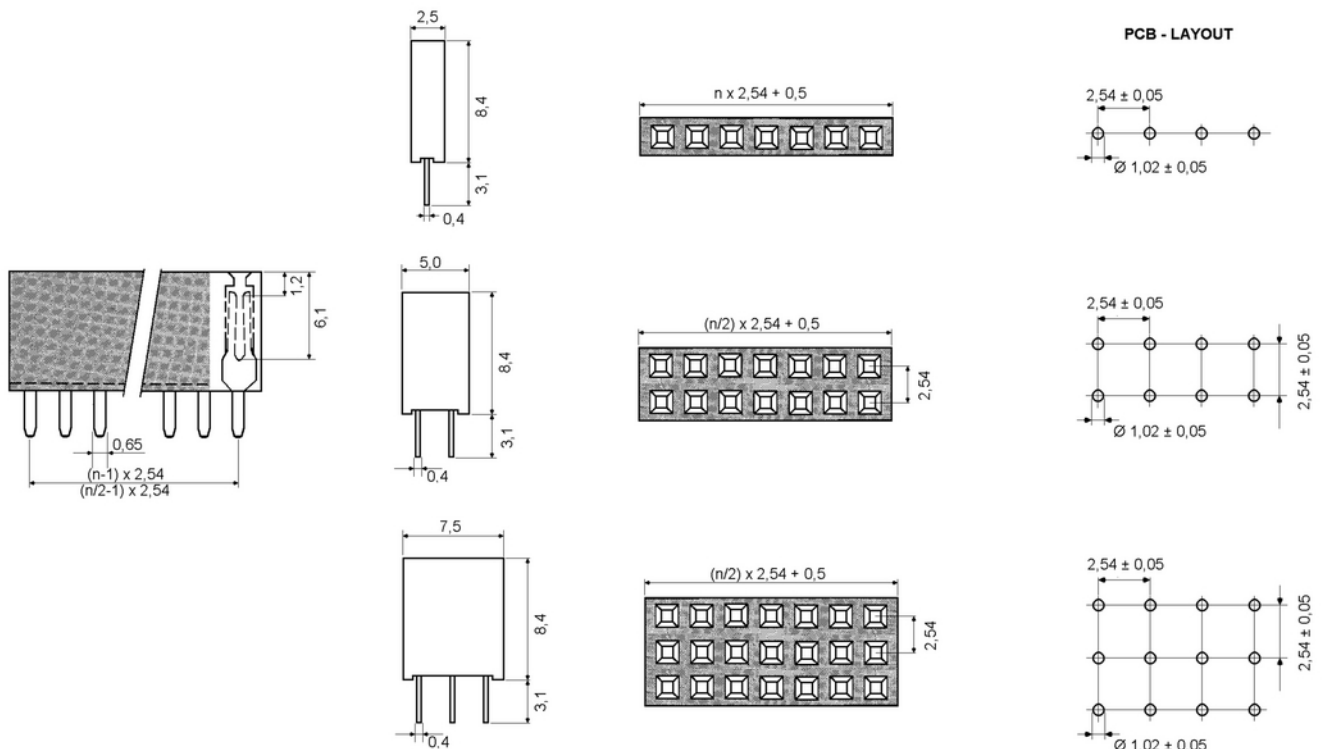
Technische Daten / Technical Data

| | |
|-----------------------|---|
| Isolierkörper | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 |
| Insulator | Thermoplastic, rated UL94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Kontakt für Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung |
| Contact Material | Contact for square pin 0,635mm, copper alloy |
| Kontaktfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) |
| Contact Surface | Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm) |
| Lötbarkeit | IEC512-12A |
| Solderability | IEC512-12A |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Contact Resistance | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 10 ⁹ Ω |
| Insulation Resistance | > 10 ⁹ Ω |
| Spannungsfestigkeit | 1000V _{DC} |
| Test Voltage | 1000V _{DC} |
| Nennspannung | 250V _{AC} |
| Voltage Rating | 250V _{AC} |
| Nennstrom | 3A |
| Current Rating | 3A |
| Temperaturbereich | -40°C ... +105°C |
| Temperature Range | -40°C ... +105°C |
| Verarbeitung | Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T |
| Processing | Reflow-soldering, detailed information in ch. T |



Gabelkontakt für Vierkantstift 0,635mm
Fork contact accepts square pin 0,635mm

© W+P PRODUCTS



| Series | Contacts* | Rows* | Plating* |
|------------|--|---|--|
| 157 | 08 02-40 Einreihig Single row 04-80 Zweireihig Double row 09-96 Dreireihig Triple row | 2 1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row 3 Dreireihig Triple row | 60 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating Au/Sn |

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.)

(* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX.: +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com
INTERNET: www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Information

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte)

| Profil Eigenschaft | Bleifreies Löten |
|---|-----------------------------------|
| Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p) | 3°C / Sek. Max. |
| Vorheizen - Temperatur Min ($T_{S_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{S_{max}}$) - Zeit ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$) | 150°C 200°C 60-180 Sekunden |
| Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L) | 217°C 60-180 Sekunden |
| Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p) | 260°C +/- 5°C |
| Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p) | 20-40 Sekunden |
| Ramp-Down Rate | 6°C / Sekunde max. |
| Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur | 8 Minuten max. |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

| Profile Feature | PB-Free assembly |
|---|----------------------------------|
| Average Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p) | 3°C / second max. |
| Preheat - Temperature Min ($T_{S_{min}}$) - Temperature Max ($T_{S_{max}}$) - Time ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$) | 150°C 200°C 60-180 seconds |
| Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L) | 217°C 60-180 seconds |
| Peak/Classification Temperature (T_p) | 260°C +/- 5°C |
| Time within 5°C of actual Peak-Temperature (t_p) | 20-40 seconds |
| Ramp-Down Rate | 6°C / second max. |
| Time 25°C to Peak Temperature | 8 minutes max. |

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:

